2022/7/6 軽金属奨学会 第25回課題研究成果発表会

同種・異種金属電磁圧接材の波状界面 形態を支配する諸因子の探索

元東京工業大学 物質理工学院 材料系 (現日本軽金属株式会社)

木村慎吾

1



- ✓ 電磁力を用いて金属板を飛翔させ高速で傾斜衝突させることで接合を得る衝撃圧接法の一種
- ✓ 数µ秒から数十µ秒という極短時間で接合が可能
- ✓ メタルジェットによって表面層を吹き飛ばすため特別な表面処理が不要
- ✓ バルクの温度上昇がほとんどない
- ✓ 接合界面に特徴的な波状模様が形成,金属の組合せによっては合金化領域や中間層 を伴う

強固に接合された健全な同種・異種金属接合を実現するために接合界面形態の制御が重要

 ✓ 主に接合する際の衝突速度(Vi)ある いは衝突点移動速度(Vc)および衝突 角度(β)によって接合の可否や波状 界面の有無が支配 (Welding windowによって整理)





 ✓ 接合できる条件や波状界面形態の特徴 は接合する金属の組合せによって変化 (主に密度差に依存)

➡
密度差が小 → 正弦波状
密度差が大 → トリガー状



[ref] Onzawa et. al Trans Japan Weld Soc., 6(1975), 18-24.

✓ 波状界面形態は主に衝突速度, 衝突角度および被接合金属の密度差に支配

✓ しかし,薄板などを用いる電磁圧接では上記以外の他の因子(接合板の厚さや質量、 表面状態等)が波状界面の形成条件,波の大きさや接合強度に及ぼす影響について 調査することが重要



本研究の目的

実験と数値解析を組み合わせ、極短時間に起こる接合界面での波状界面の形成や 急激な温度上昇および冷却現象を明らかにすることにより、電磁圧接界面形態に及 ぼす諸因子の影響について探索する Model1:電磁場-構造連成解析(ANSYS/Emag-mechanical)



■ Model2:衝突解析(ANSYS/Autodyn)





□ 目的

✓ 衝突時の運動エネルギーが接合界面形態に及ぼす影響を調査



□ 実験条件

Flyer Plate Thickness (mm)	Gap (mm)	Charging voltage (kV)	Impact Angle (°)	Impact Velocity (m/s)
0.4	2.4	12.25	14.3	375
0.6	1.8	14.15	14.5	354
0.8	1.5	16	14.0	372
1.0	1.5	19	14.3	402

 ✓ AI板をFlyer plateとして 板厚を系統的に変化



- ✓ 全ての条件においてトリガー状の波状界面が形成
- ✓ Flyer plateの板厚が増加するほど波のサイズが大きくなっていた

数値解析で再現した波状界面形態



✓ 全ての条件においてトリガー状の波状界面が形成
✓ Flyer plateの板厚が増加するほど大きなサイズの波が形成
⇒実験結果と良い一致を示している

t_f=0.4mmおよび1.0mmにおける数値解析で再現した波状界面形成過程



- ✓ 衝安界後広残留地をいるは風擾層増速をが類字の数の減が形成地利率は条件では少
- ✓ なのりが受出されの教授」屋り込めれた量もわずのが見い場合の方が大きがおみを巻くような物
- ✓ 衝突動後が顕著であルゼェットの入り込みの増加によって波のサイズが増加

■ 背景



- ✓ 電磁圧接ではParent plateが衝突中に大きく変形してしまう場合がある
- ✓ 衝突中にこのような大きな変形が起こる場合, 衝突速度や衝突角度の変化や衝突 エネルギーがParent plateの変形に消費されることが考えられる



目的

Parent plateの板厚を変化させることでParent plateの変形能を変化させ、Parent plateの変形が接合界面形態に及ぼす影響を調査

- 対象
- ✓ 変形しやすいAIのO材をParent plateとしたAI/AI同種接合材



CE:4kJ Gap:2mm Flyer plate : A1050-O(t=0.4mm) Parent plate : A1050-O(t=0.2~1.0mm)







✓ t_pが薄い程接合界面に現れる波が
小さくなる



形成される波の大きさが変化した理由を調査するため数値解析を実施



✓数値解析結果においてもParent plateの板厚が厚くなるほど 波が大きくなっていた

各条件における圧力分布の比較



- ✓ Parent plateが薄い場合, Parent plateとAnvilの間で衝突が起こり大きな圧力上昇が発生
- ✓ 衝突点近傍の圧力上昇領域はParent plateが薄い条件の方が狭くなっていた

Parent plateの変形によってエネルギーが消費された結果, 衝突点にかかる力が減少し、 形成される波が小さくなった可能性 ✓ AI/CuとAI/Niの2つの組合せで電磁圧接
→金属の密度差はほぼ同じだがParent plateの硬さが異なる
Cu: 76.9HV Ni: 181HV







✓ どちらの接合界面にもトリガー状の波状界面が形成
✓ AI/Niの方がAI/Cuに比べ波高の小さい波が形成

数値解析(SPH法)を用いて再現した波状界面形態



□ 実験で得られた接合界面形態



✓ SPH法で再現した波状界面においても実験で得られた接合界面同様にAI/Culc比 べてAI/Niの方が小さいサイズの波となっていた

数値解析(SPH法)を用いて再現した波状界面形成過程



- ✓ 衝突点後方へのメタルジェットの入り込みはAI/Cuに比べてAI/Niの方が小さく なっていた
- ✓ AI/Cuの組合せでは衝突点が通り過ぎた後でも波の形状変化が起こっていたが AI/Niの組合せでは起こっていなかった

→Niの方が硬く、変形抵抗が大きいためにメタルジェットの入り込みが小さくなり 形成する波が小さくなった

目的

実験手法と数値解析手法を組み合わせて表面粗さが電磁圧接界面形態に及ぼす影響を解明

- □ 供試材
 - ✓ Flyer plate : Al
 - ✓ Parent plate : Cu

■ #120にて研磨したParent plate表面



□ 実験条件

Condition	Charging energy (kJ)	Gap (mm)	Overlap (mm)	Surface grind No.	Sq (μm)	↓
1	3	2.4	3	2000	0.368	
2				1000	0.462	
3				600	0.743	
4				120	1.964	



Parent plate表面のみに接合 方向に対して垂直にエメリー 紙で傷をつけ接合を実施

100µm



最も表面が粗い#120において

- ✓ 接合長さが増加
- ✓ 他の条件と比べて波高が大きな波が形成

Wavy interface morphology reproduced by numerical analysis method 20/24

- model 2の改良
- ✓ Parent plate表面に20µm間隔で凹凸 (10µm x 10µm)を設置し、表面粗さを模 擬
- ✓ その他の解析条件はこれまでと同様



■ これまでのmodel 2にて再現した波状界面



凹凸を含んだmodel 2にて再現した波状界面



✓ 凹凸があるモデルにおいて大きな波が形成



✓ Parent plate表面のこぶが衝突点前方へ放出されたメタルジェットに吹き飛ばされ、衝突点後方へ巻き込まれるメタルジェットの一部になることで衝突 点後方への入り込みが増加し、大きな波を形成

22/24

<u>衝突速度Viおよび衝突角度β以外の因子が接合界面形態に及ぼす影響</u>

Flyer plateの板厚を変え, Flyer plateの運動エネルギーを増加させると形成する波が大きくなること, Parent plateの厚さが薄い場合には, 衝突時に大きく変形し, それにより衝突エネルギーが費やされ, 波が小さくなること, Parent plateの変形抵抗が大きいと衝突 点後方へのメタルジェットの入り込みが小さくなるために形成される波が小さくなること, Parent plateの表面粗さが大きくなるとメタルジェットが表面に存在する障害物を巻き込むことでより大きな波が形成することが明らかとなった.



従来知られていた接合する金属の密度差やViやβのみならず,被接合材の表面状態 や被接合材の厚さや変形抵抗の違いによるエネルギー変化がメタルジェットの放出挙 動に影響し,これにより形成される接合界面形態が大きく変化することを明らかにできた

公益財団法人軽金属奨学会特別奨学生の支援に対し 深く感謝申し上げます